



主要特点

内部集成 3: 8 译码器

通道数目: 7

通带频率: 1.9 - 3.2 GHz

2.2 - 3.7 GHz

2.7 - 4.6 GHz

3.6 - 6.1 GHz

5.1 - 8.9 GHz

7.9 - 13.8 GHz

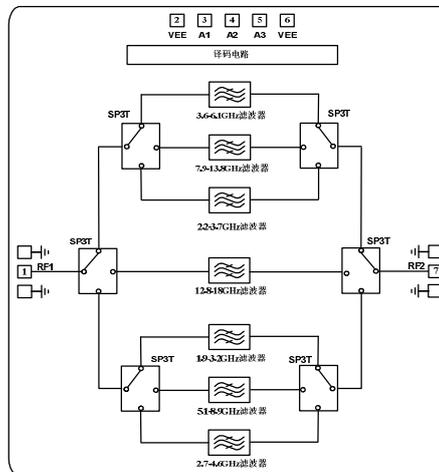
12.8 - 18 GHz

功耗: -5 V @ 9 mA

输入 P-1: 22 dBm

芯片尺寸: 3.5 × 4.5 × 0.1 mm³

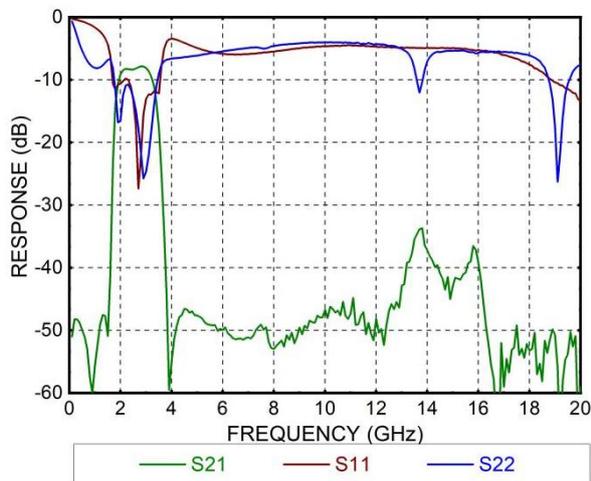
功能框图



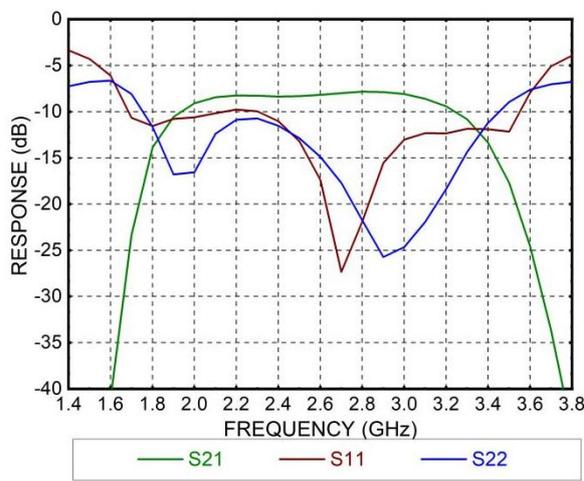
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $VEE = -5\text{V}$)

参数	1.9-3.2GHz	2.2-3.7GHz	2.7-4.6GHz	3.6-6.1GHz	5.1-8.9GHz	7.9-13.8GHz	12.8-18GHz	单位
插入损耗	9	9	9	9	9	9	9	dB
带内平坦度	±1	±1	±1	±1	±1	±1	±1	dB
回波损耗	10	10	10	10	10	10	10	dB
带外抑制	45@1.5GHz 45@3.8GHz	45@1.7GHz 45@4.4GHz	45@2.2GHz 45@5.4GHz	45@2.9GHz 45@7.2GHz	45@4.2GHz 45@10.2GHz	45@6.6GHz 45@15.6GHz	45@11GHz 45@21.5GHz	dB

1.9-3.2GHz反射系数

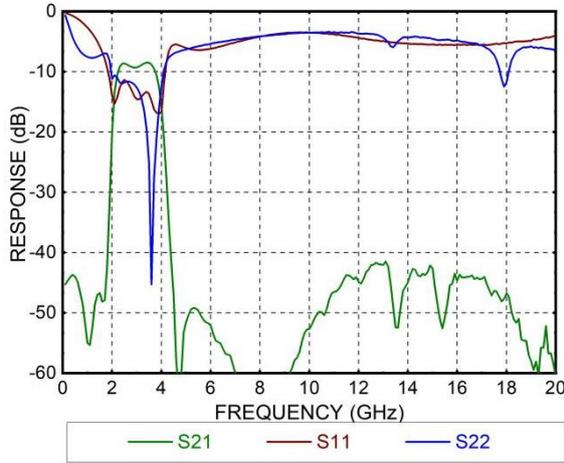


1.9-3.2GHz反射系数

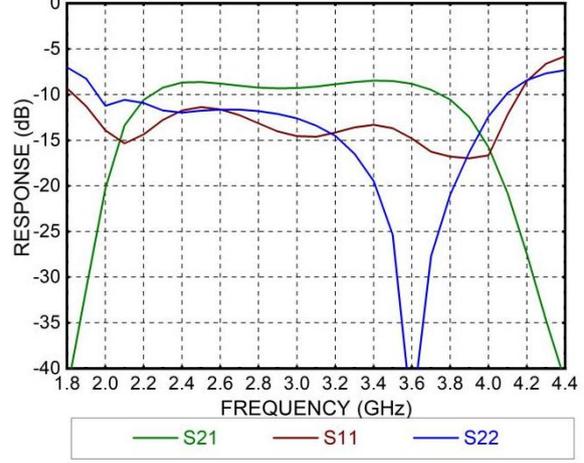




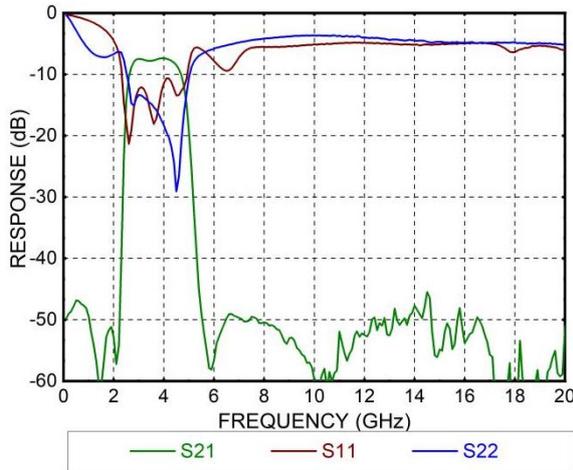
2. 2-3.7GHz反射系数



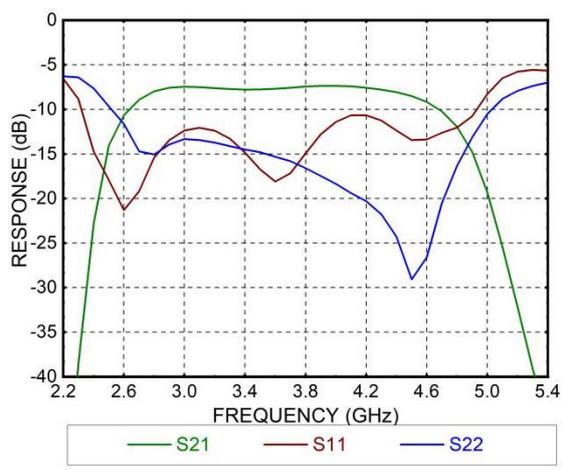
2. 2-3.7GHz反射系数



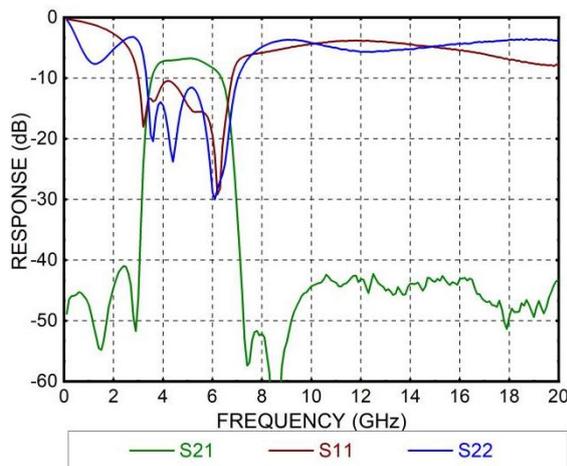
2. 7-4.6GHz反射系数



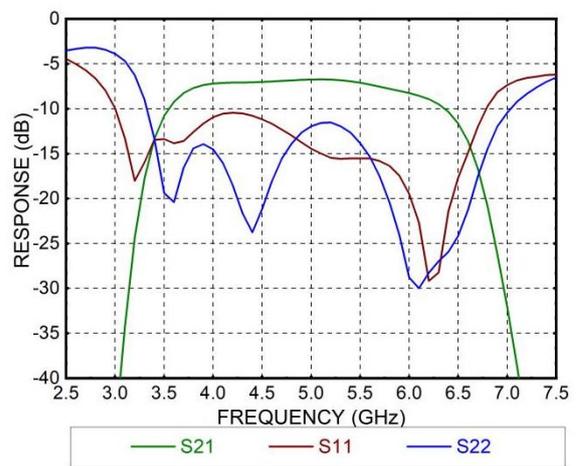
2. 7-4.6GHz反射系数



3. 6-6.1GHz反射系数

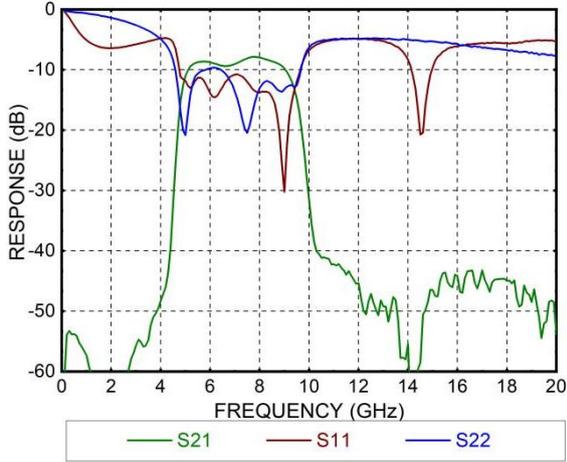


3. 6-6.1GHz反射系数

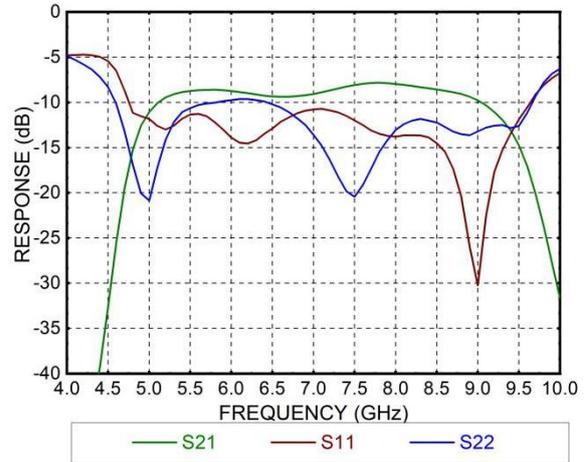




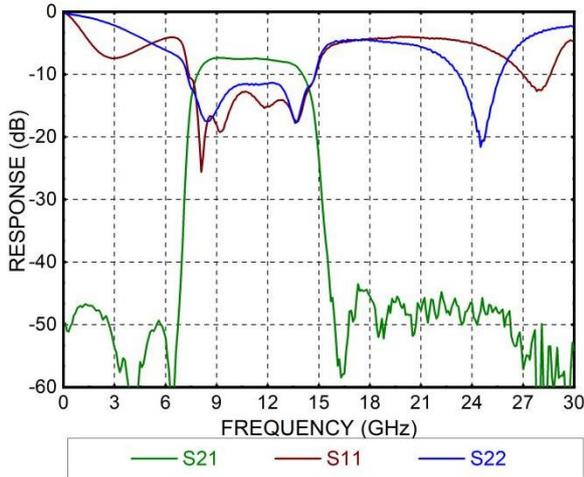
5. 1-8.9GHz反射系数



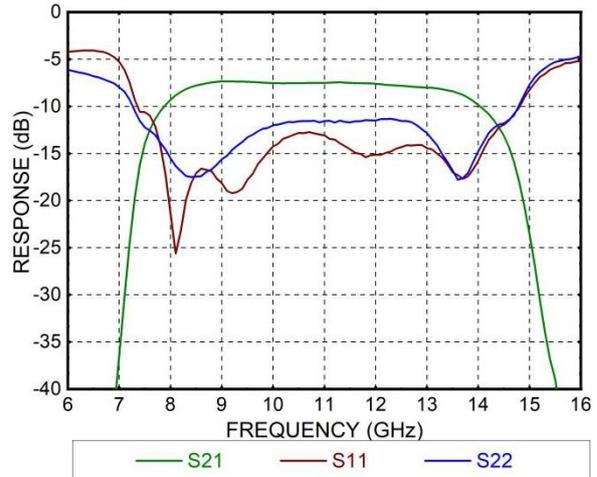
5. 1-8.9GHz反射系数



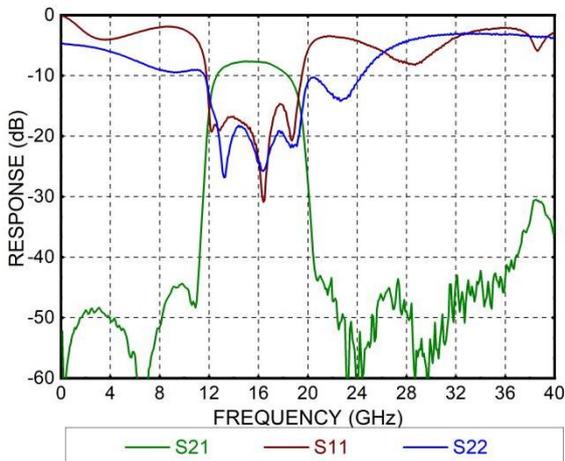
7. 9-13.8GHz反射系数



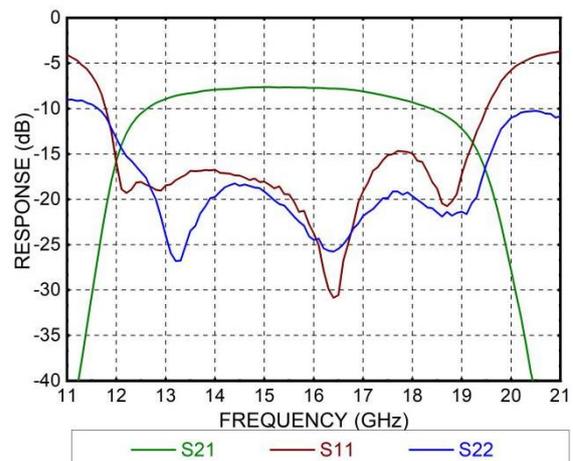
7. 9-13.8GHz反射系数



12. 8 - 18GHz反射系数

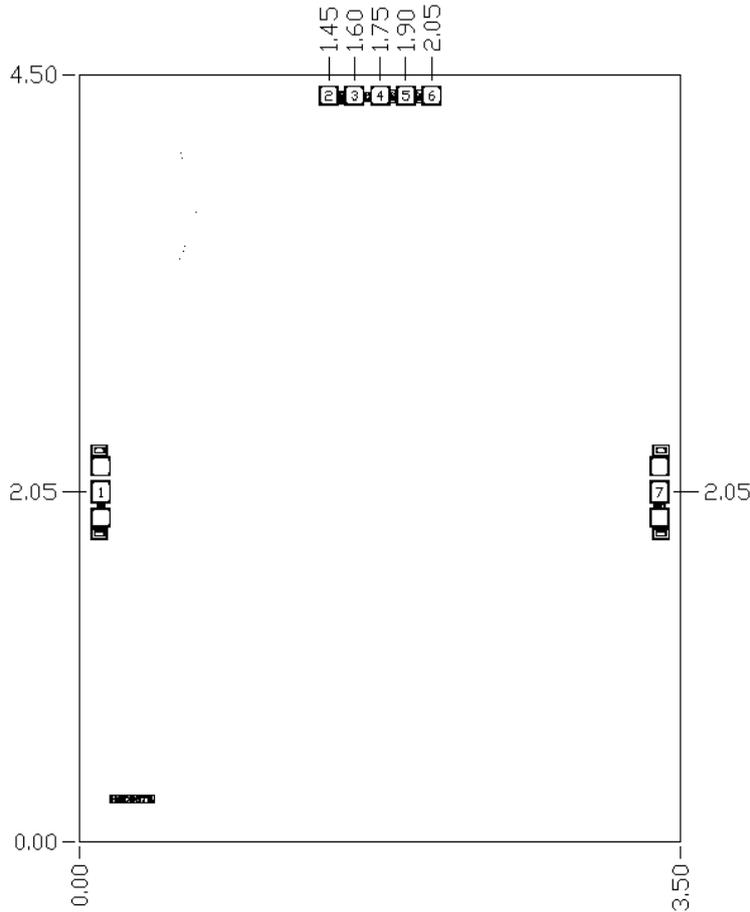


12. 8 - 18GHz反射系数



物理参数

单位: mm



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RF1	该焊盘是 RF 信号输入端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
7	RF2	该焊盘是 RF 信号输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
2, 6	VEE	该焊盘是驱动电路电源端口, 使用时任选一端接-5V 电压
3-5	A1-A3	该系列焊盘是控制端口, 控制关系见真值表
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

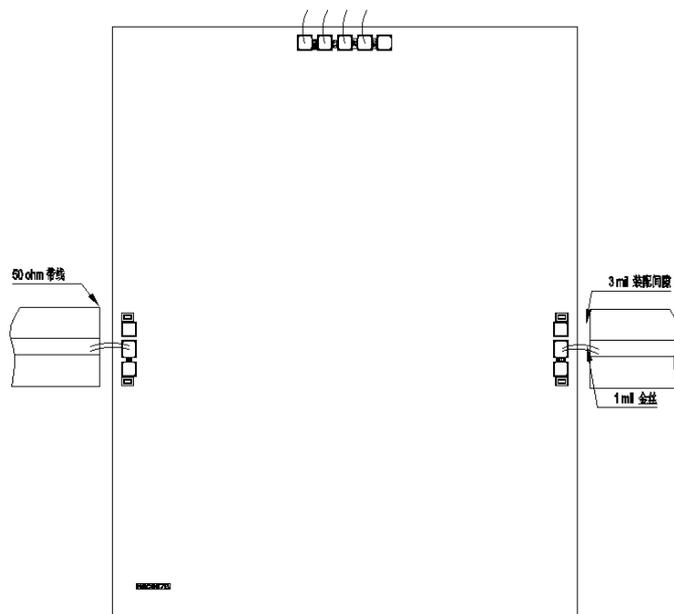


真值表

通道	A1	A2	A3
1.9-3.2GHz	0	0	0
2.2-3.7GHz	0	0	1
2.7-4.6GHz	0	1	0
3.6-6.1GHz	0	1	1
5.1-8.9GHz	1	0	0
7.9-13.8GHz	1	0	1
12.8-18GHz	1	1	0

“0”电平范围：0~0.2V，“1”电平范围：2.3~5V

推荐装配图



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 $120 \times 100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN；厚度：0.6 μm ，

极限参数

1. 电源电压：-6 V
2. 射频输入功率：+27 dBm
3. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$